

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2013-048

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

关于向全资子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 提供借款对象：成都士兰半导体制造有限公司（以下简称“成都士兰”）
- 提供借款金额：分次提供最高不超过13,000万元
- 提供借款期限：最长为3年
- 提供借款利率：参考银行相应期限的贷款基准利率，最高上浮不超过10%

一、本次为全资子公司提供借款事项概述

1、借款金额、期限及利率

在三年内，为成都士兰半导体制造有限公司提供最高不超过 13,000 万元人民币的借款，借款期限最长为三年，具体以合同签订为准。

借款的利率参考银行相应期限的贷款基准利率，最高上浮不超过 10%。

2、资金用途

该款项用于成都士兰一期工程项目建设及补充流动资金、归还银行贷款。

3、本次为全资子公司提供借款事项不构成关联交易。

4、本次借款已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，该事项无须提交公司股东大会审议。

二、成都士兰半导体制造有限公司的基本情况

1、公司名称：成都士兰半导体制造有限公司

2、成立时间：2010 年 11 月 18 日

3、注册地址：成都-阿坝工业集中发展区内

4、注册资本：20,000 万元

5、法定代表人：陈向东

6、经营范围：集成电路、半导体分立器件、发光半导体等半导体产品的设计、制造、销售；货物进出口。

7、股东情况：成都士兰为公司全资子公司，公司持有成都士兰 100%股权。

8、截至 2012 年 12 月 31 日，成都士兰经审计的总资产为 35,793 万元，负

债为 16,712 万元，净资产为 19,081 万元。2012 年营业收入 0 万元，净利润为 -681 万元。截至 2013 年 6 月 30 日，成都士兰未经审计的总资产为 34,698 万元，负债为 16,110 万元，净资产为 18,588 万元。2013 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润为-493 万元。成都士兰尚处于建设期，无营业收入。

三、本次借款对公司的影响

本次借款事项虽然可能较长时间占用公司的流动资金，但有利于加快成都士兰的建设、降低综合财务成本，有利于实施公司总体经营的发展战略。因此，本次借款事宜，不会影响公司的持续经营，风险可控，不会损害全体股东及公司的利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2013 年 11 月 12 日